

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-024

# 山东天岳先进科技股份有限公司

## 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“碳化硅半导体材料项目”投入募集资金金额的情况下，公司拟使用人民币126,000.00万元的募集资金向公司全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供无息借款以实施公司募集资金投资项目，公司将通过提供无息借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体上海天岳所开设的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责办理借款手续以及后续管理工作。借款期限自借款实际发放之日起不超过三年，上海天岳可根据实际经营情况提前偿还或到期续借。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

现将具体内容公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00

元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金
1	碳化硅半导体材料项目	250,000.00	200,000.00
	合计	<b>250,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

## 三、前次使用募集资金提供借款实施募投项目的情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟使用人民币 34,000.00 万元的募集资金向上海天岳增资以及拟使用人民币 40,000.00 万元的募集资金向上海天岳提供无息借款，以实施公司募集资金投资项目“碳化硅半导体材料项目”。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-021）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向全资子公司上海天岳增资的增资款人民币 34,000.00 万元已全部到位，相关工商变更已办理完成；公司已使用募集资金向上海天岳提供借款 11,000.00 万元。

## 四、本次使用募集资金提供借款实施募投项目的情况

根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目“碳化硅半导体材料项目”的实施主体是上海天岳半导体材料有限公司。根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，在扣除前次使用募集资金向上海天岳增资及提供借款金额后，公司拟使用募集资金 126,000.00 万元

向上海天岳提供无息借款，以实施募投项目“碳化硅半导体材料项目”。借款期限自借款实际发放之日起不超过三年，上海天岳可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。

#### 五、本次使用募集资金提供借款的全资子公司情况

- 1、公司名称：上海天岳半导体材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000MA1H32XT3F
- 3、法定代表人：宗艳民
- 4、成立时间：2020年6月2日
- 5、注册资本：40,000万元人民币
- 6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路1211号10幢301室
- 8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 9、股权结构：公司持有上海天岳100%的股权。

#### （二）最近一年的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	107,619.18
净资产	34,671.27
项目	2022年
营业收入	84.17
净利润	-3,918.24

注：上述2022年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 六、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司使用募集资金向全资子公司上海天岳提供无息借款，有利于募投项目的顺利实施，募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的要求，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。同时，上海天岳是公司全资子公司，公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控。

## 七、本次提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，上海天岳已开立了募集资金专户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述募集资金专户仅用于公司首次公开发行股票并在科创板上市募投项目“碳化硅半导体材料项目”的存储和使用，不得用作其他用途。

公司及全资子公司工程将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

## 八、本次提供借款的审议程序

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

## 九、专项意见说明

### （一）监事会意见

监事会认为：公司本次提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资

金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

## （二）独立董事意见

1、公司本次使用募集资金向全资子公司上海天岳提供借款以实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

2、同意《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

## （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用募集资金向全资子公司上海天岳提供借款以实施募投项目，已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。

2、公司本次使用募集资金向全资子公司上海天岳提供借款以实施募投项目，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司上海天岳提供借款以实施募投项目无异议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日